



Creating the Future with Adhesive Technologies

Linkage + Technology

LINTEC

夢をカタチにする粘・接着技術のリンテック

会社概要

■本 社	東京都板橋区
■証券コード	7966(東証1部)
■設 立	1934年(昭和9年) 10月15日
■資本金	232億円(11年3月末)
■従業員数	4,198人(11年3月末):連結
■売上高	2,127億円(11年3月期):連結
■決算日	3月31日
■事業内容	粘着製品、粘着関連機器、特殊紙、 剥離紙・剥離フィルムなどの開発・製造・販売
■事業拠点	国内連結子会社: 4社 海外連結子会社: 19社



1934年
(昭和 9年)

**ガムテープメーカー「不二紙工株式会社」
設立(東京・板橋)** ※1984年 FSK株式会社に商号変更



1960年
(昭和35年)

**シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルムの
製造・販売を開始**

以降、屋内外装飾、二輪・自動車関連などの
工業分野に粘着事業を拡大



1984年
(昭和59年)

**UV硬化型ダイシングテープを開発し、
半導体関連分野に本格参入**

1987年
(昭和62年)

米国のマディコ社を子会社化

1990年
(平成 2年)

**四国製紙、創研化工と合併
「リンテック株式会社」に商号変更**

特殊紙、剥離紙・剥離フィルムから粘着紙・
粘着フィルム、関連機器分野にまで業容を拡大



1991年 液晶関連分野に本格参入

(平成 3年)

1993年 琳得科(天津)実業有限公司を設立

(平成 5年)

1994年 リンテック・インドネシア社を設立

(平成 6年)

2000年 リンテック・インダストリーズ(マレーシア)社を設立

(平成12年)

2002年 琳得科(蘇州)科技有限公司を設立

(平成14年)

リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(韓国)社を設立

2003年 リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(台湾)社を設立

(平成15年)

2004年 リンテック・コリア社を設立

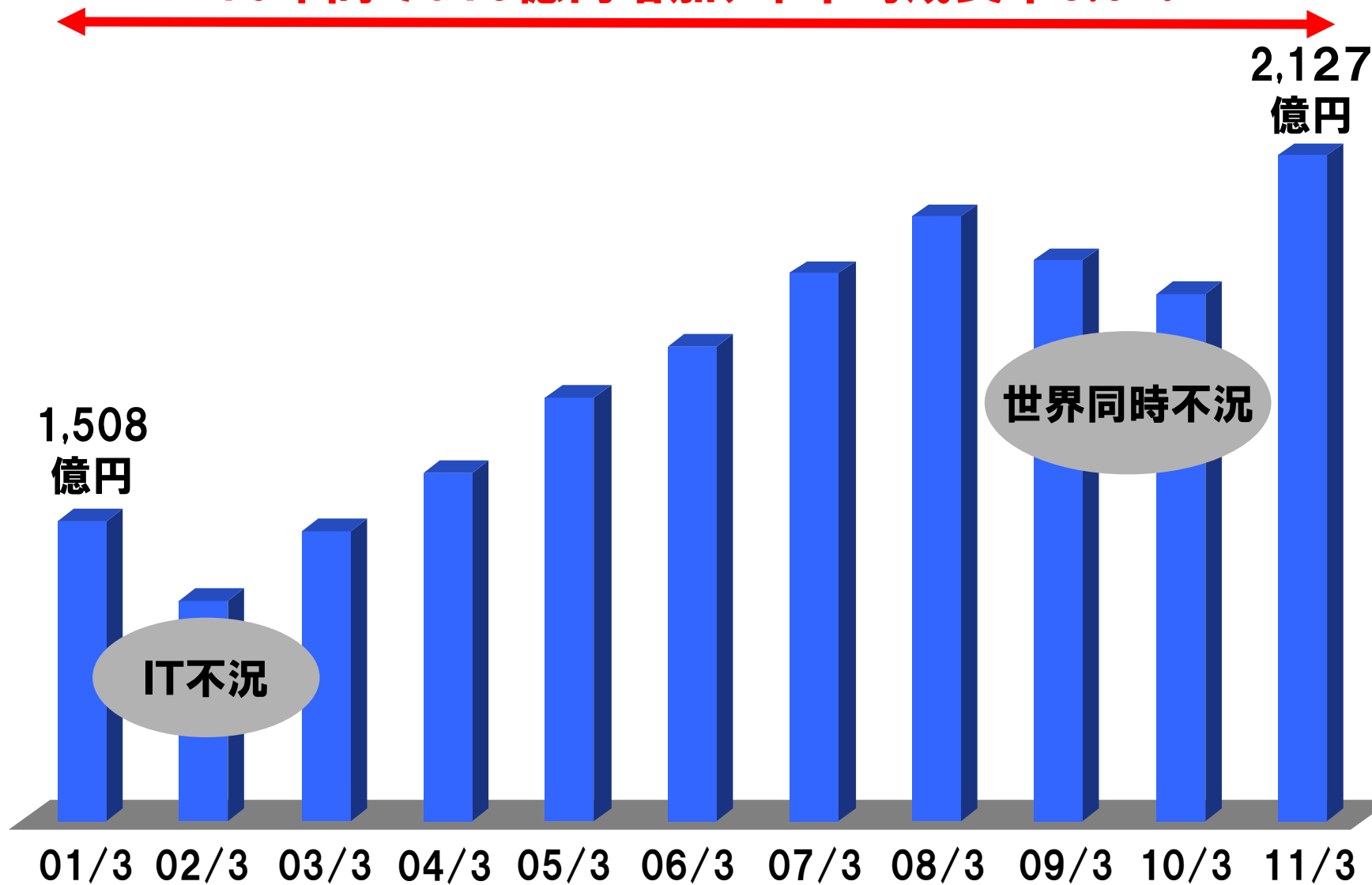
(平成16年)

2011年 リンテック(タイランド)社を設立

(平成23年)

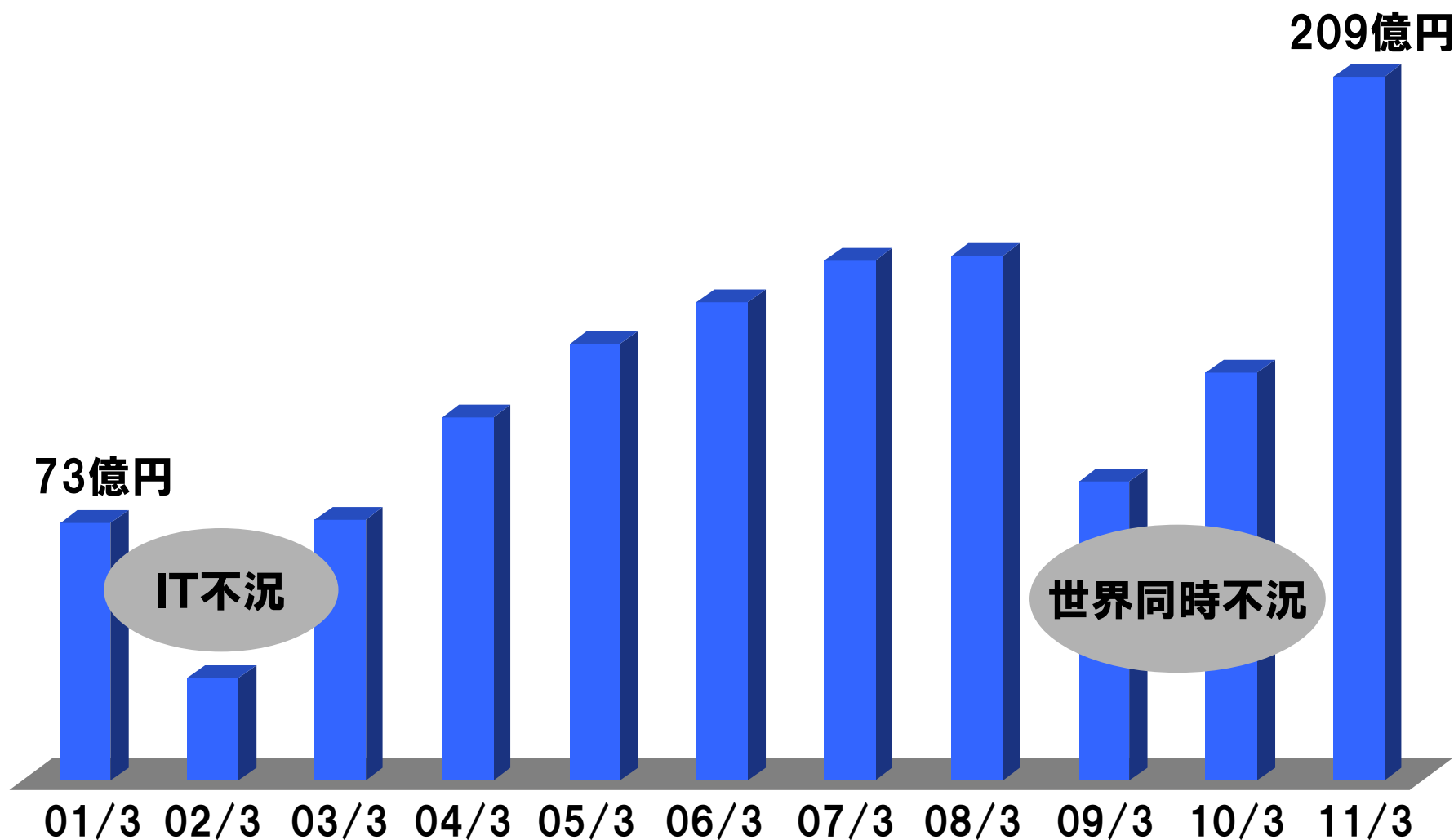


10年間で619億円増加、年平均成長率3.5%

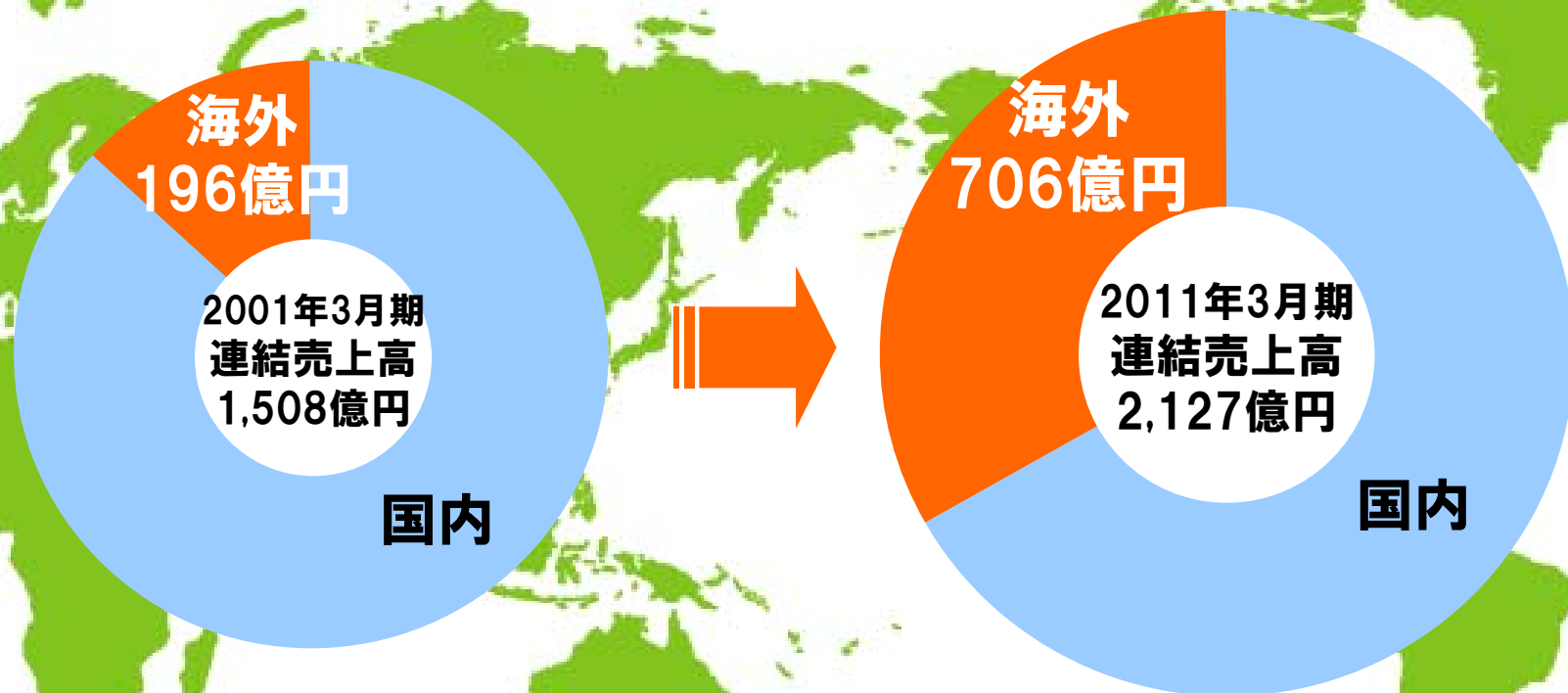


業績の推移／営業利益

10年間で136億円増加、年平均増加率11.1%



10年間で510億円増加、年平均成長率13.7%
(特にアジア地域売上高の年平均成長率は18.2%)

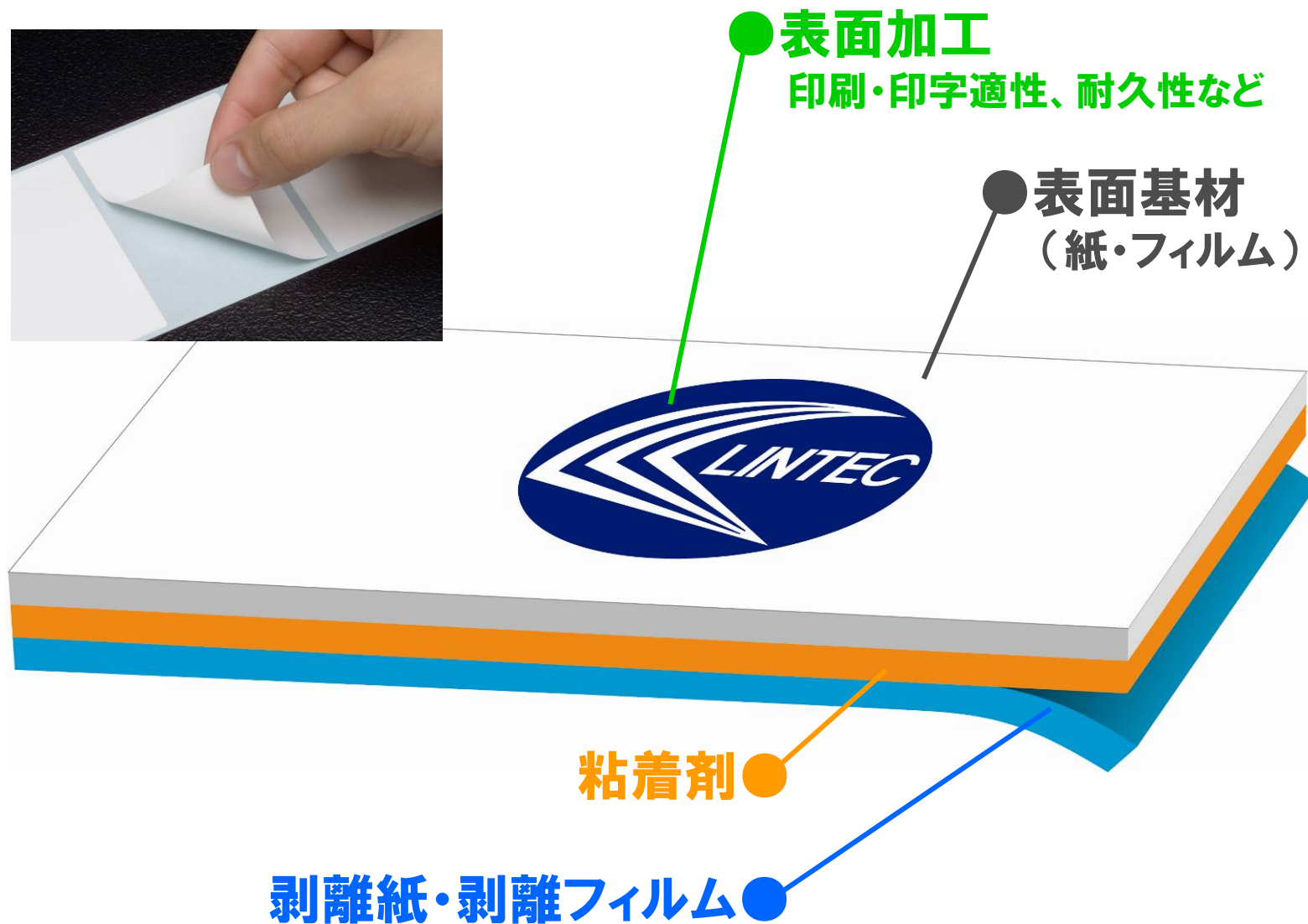


13.0%

海外売上高比率

33.2%

粘着製品の基本構成



トータルに自社技術で対応

四つの基盤技術と事業セグメント

基盤技術

1

粘着応用技術

2

表面加工技術

3

システム化技術

4

特殊紙製造技術

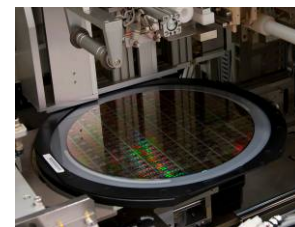
印刷材・産業工材関連

- ・印刷・情報材事業部門
- ・産業工材事業部門



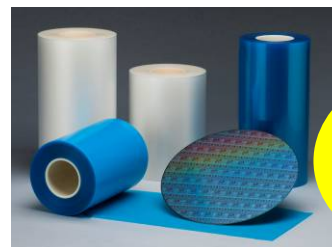
電子・光学関連

- ・アドバンストマテリアルズ事業部門
- ・オプティカル材事業部門



洋紙・加工材関連

- ・洋紙事業部門
- ・加工材事業部門



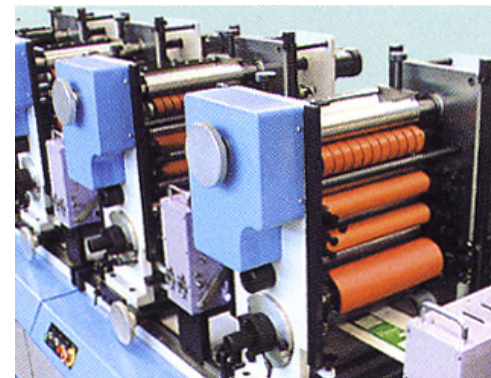
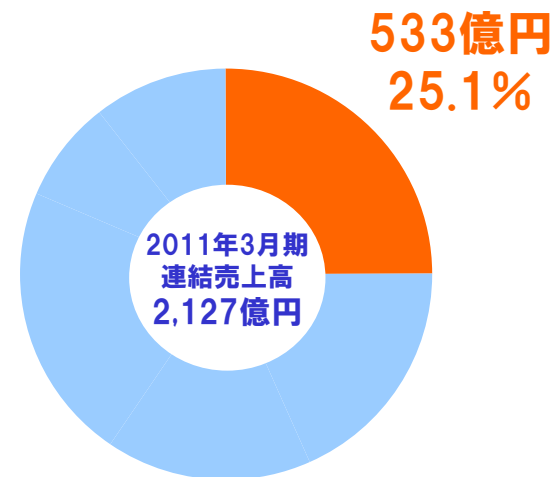
粘着素材
＋
関連機器



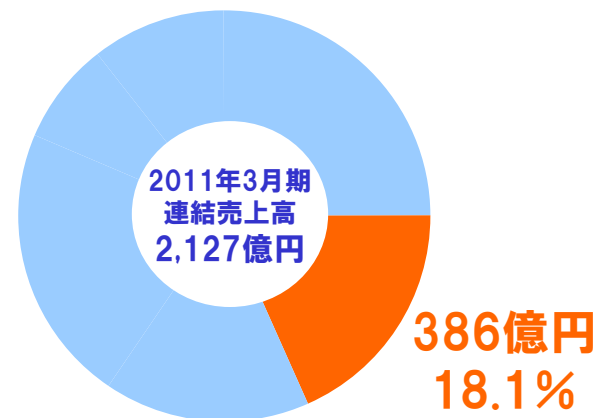
●シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルム

- 粘着剤によって、永久接着タイプ・再剥離タイプ・再貼付タイプに分けられる
- 印刷・印字適性、耐久性、耐熱性、耐水性、低温適性、曲面貼付性、寸法安定性、意匠性などに優れ、さまざまな用途や使用環境に対応

●ラベル印刷機 など



- 屋外看板・広告用フィルム
- 内装用化粧シート
- ウィンドーフィルム
- 太陽電池用バックシート
- 自動車用粘着製品
- 工業用粘着テープ
- ラベリングマシン など



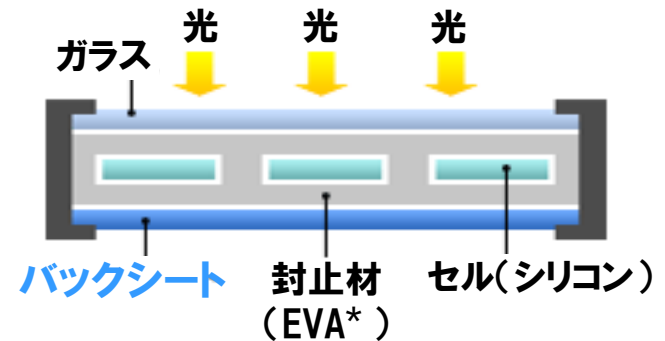
太陽電池用バックシート

- 太陽電池パネルの裏面を保護するシート
- 屋外使用への耐久性、
発電効率向上のための高反射、
電気絶縁性などが求められる
- 地球温暖化対策として、
各国で導入推進策が図られており、
今後も大きな成長が期待される

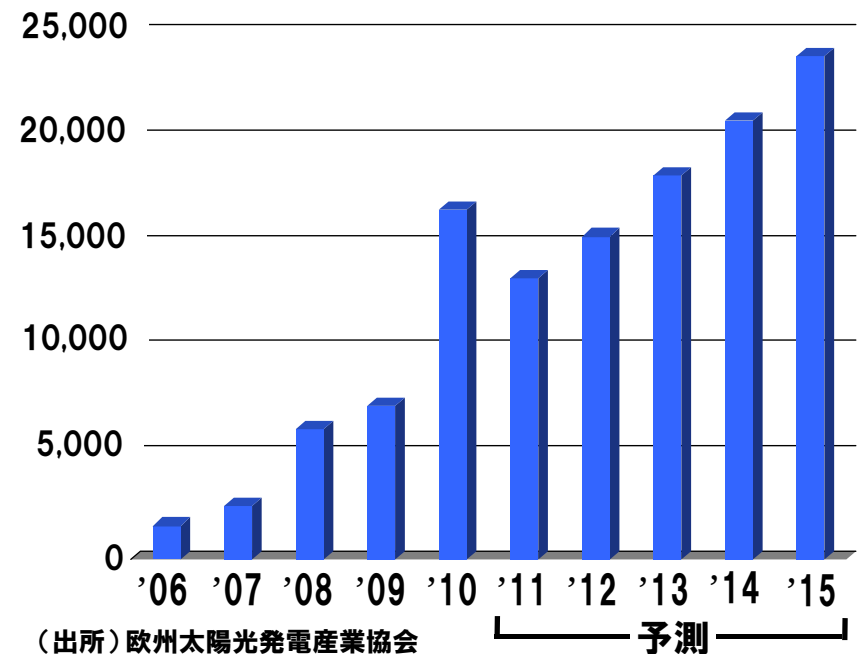


*EVA = エチレン酢酸ビニル

太陽電池パネルの構造



● 太陽電池システム需要予測 (MW)

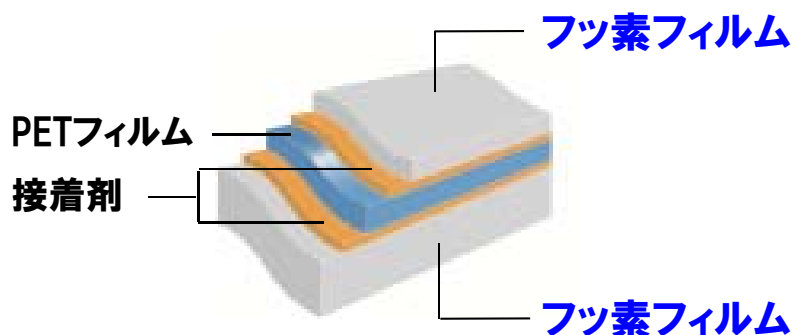


当社グループのバックシートの特徴

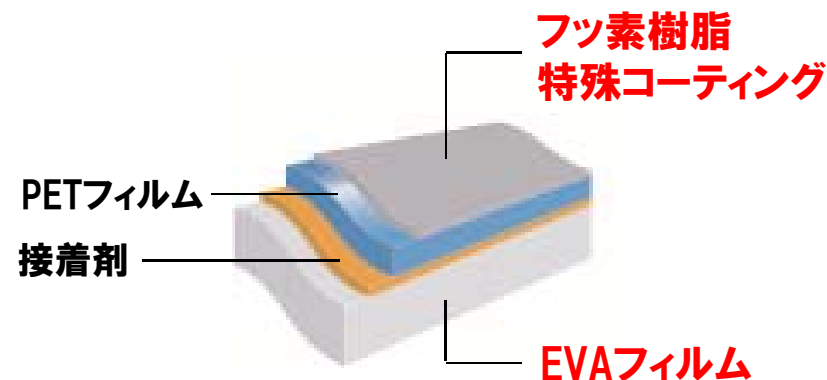
- 一般的に使用されるフッ素フィルムに代え、フッ素樹脂のコーティングとEVAフィルムを採用
- 耐久性、耐水性、電気絶縁性、封止材との接着性などに優れる
- 価格競争力に優れ、安定供給も可能



(他社品)



(当社グループ製品)



当社グループのバックシート供給体制



- ・米国子会社のマディコ社で欧米向け、千葉工場と三島工場（愛媛県）で国内・アジア向けを製造
- ・バックシートの需要拡大に応じて、今後も生産能力の増強を図る

●ドアサッシ用塗装代替フィルム



独自の材料設計によって、
空気を抜けやすくし、貼付を容易に



空気の入った状態



空気の無い状態

●アルミホイール用保護フィルム

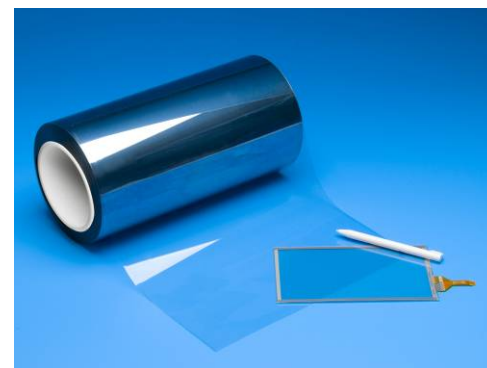
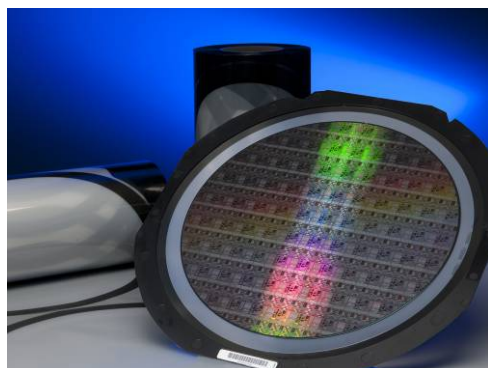
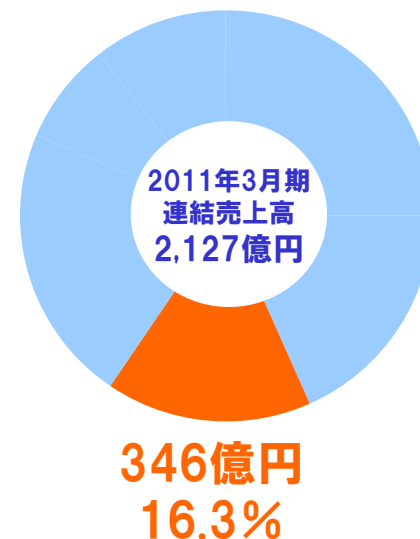


●マーキングフィルム

●ウインドーフィルム



- 半導体関連テープ・関連装置
- 積層セラミックコンデンサー製造用
コートフィルム
- タッチパネル関連製品
- 薄型テレビ用光学機能性フィルム など



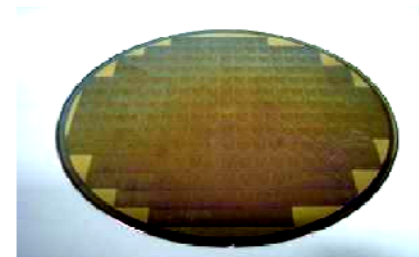
半導体チップの製造工程

【前工程】

単結晶シリコン
インゴット



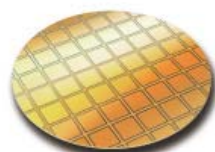
ウェハ



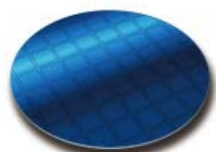
回路形成ウェハ

【後工程】

※当社テープ・装置を使用



回路形成
ウェハ



表面保護
テープ貼付



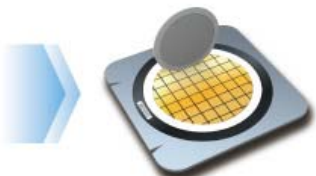
裏面研磨
(薄型化)



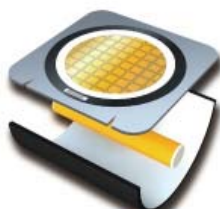
ダイシング
テープ貼付



表面保護
テープ剥離



ダイシング
(ウェハ切断)



テープへの
紫外線照射



ピックアップ



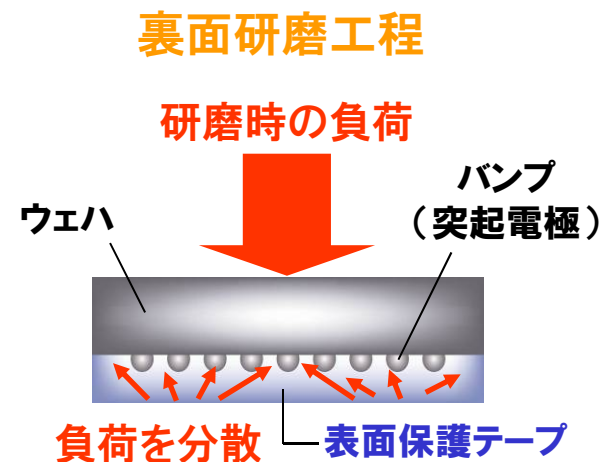
実装



樹脂封止

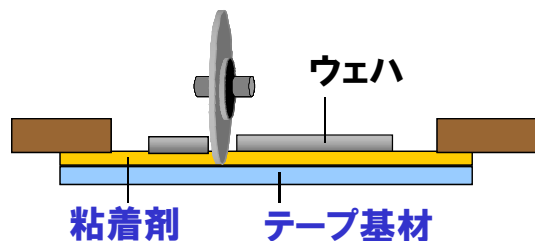
● 極薄・ハイバンプウェハ対応表面保護テープ

- ・特殊設計により、研磨後の薄型ウェハの反りを抑制
- ・回路面に形成されたバンプの凹凸にも、すき間なく貼ることができる、ウェハ表面の汚染を防止
- ・ウェハにかかる研磨時の負荷を分散して破損を抑制



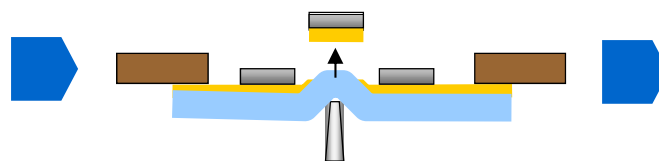
● ダイシング・ダイボンディングテープ

ダイシング(切断)工程



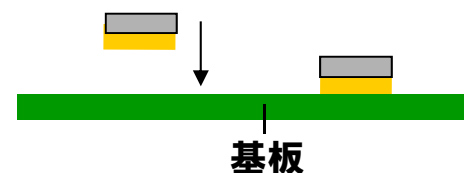
チップをしっかりと固定

ピックアップ工程



チップ裏面に粘着剤を転写

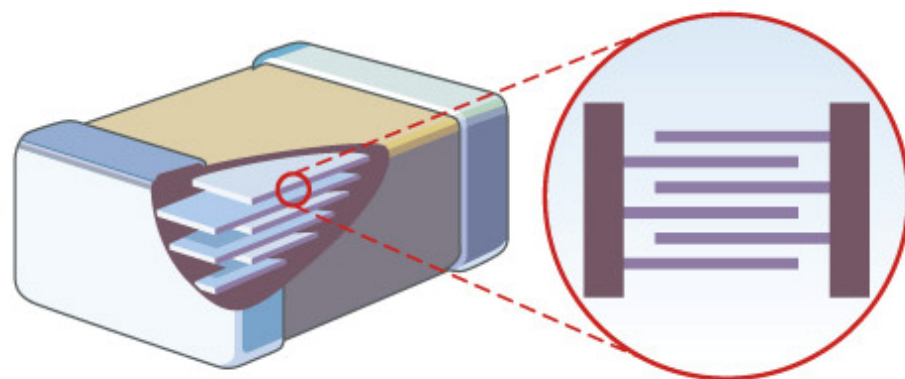
ダイボンディング(実装)工程



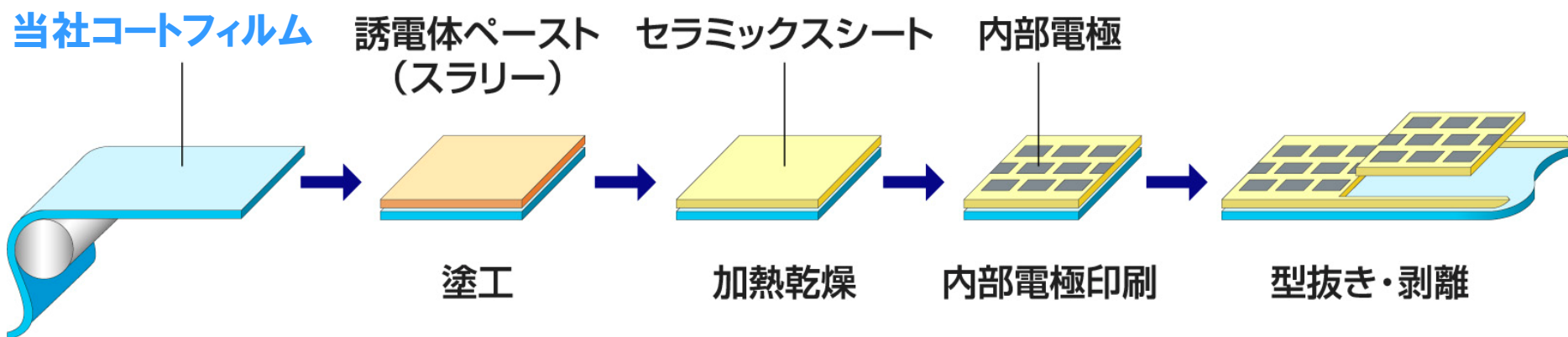
基板実装時の
接着剤塗布工程が不要に

積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム

■積層セラミックコンデンサーの構造

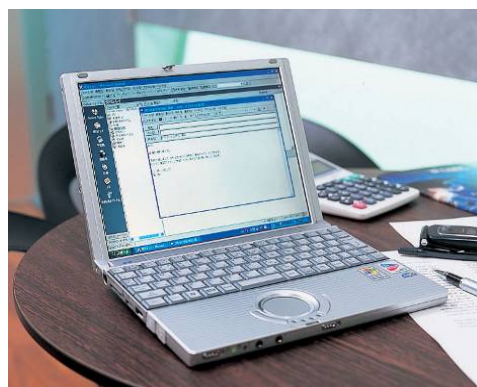
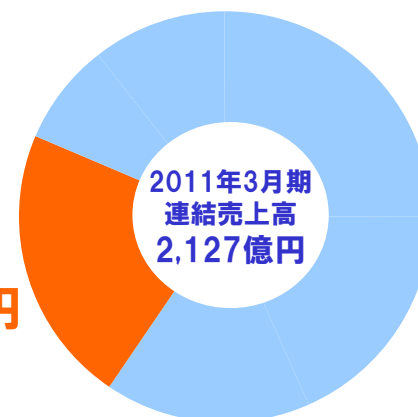


■積層セラミックコンデンサーの製造工程

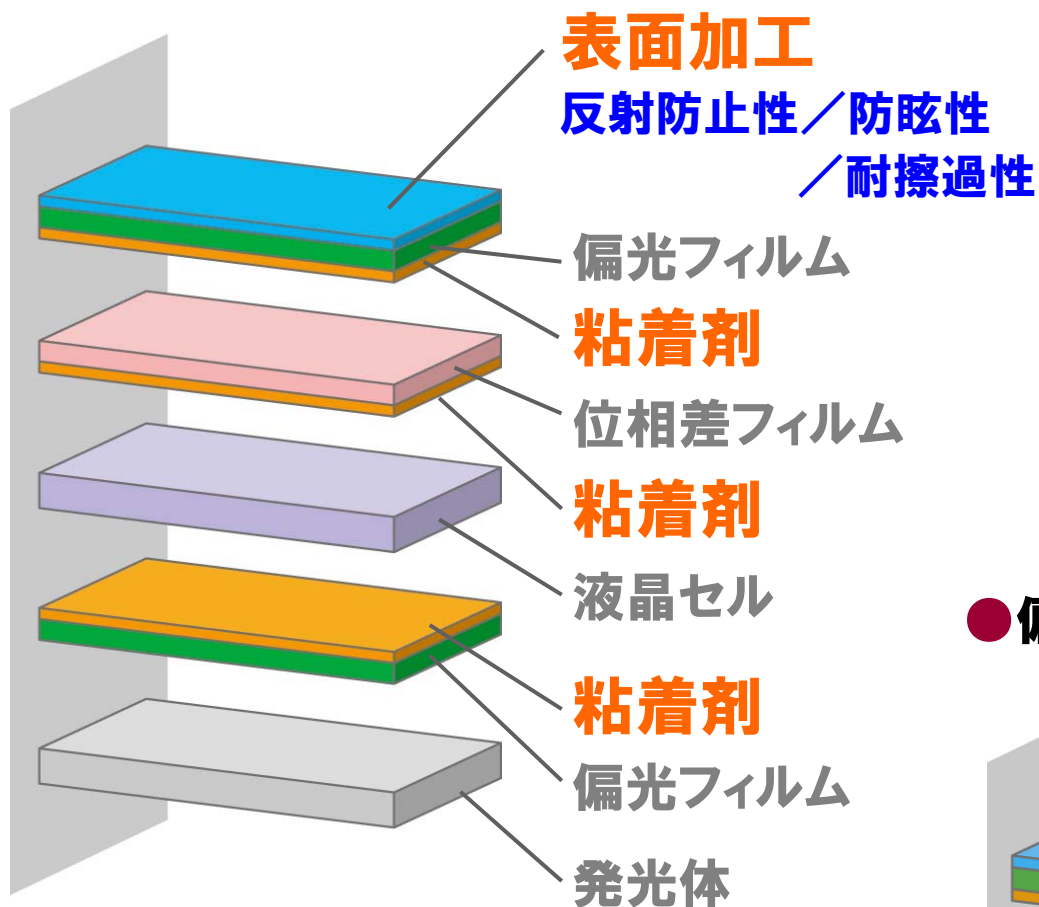


- 液晶用偏光・位相差フィルム / 粘着加工
- 液晶用偏光フィルム / 表面加工
- 偏光フィルム用保護フィルム など

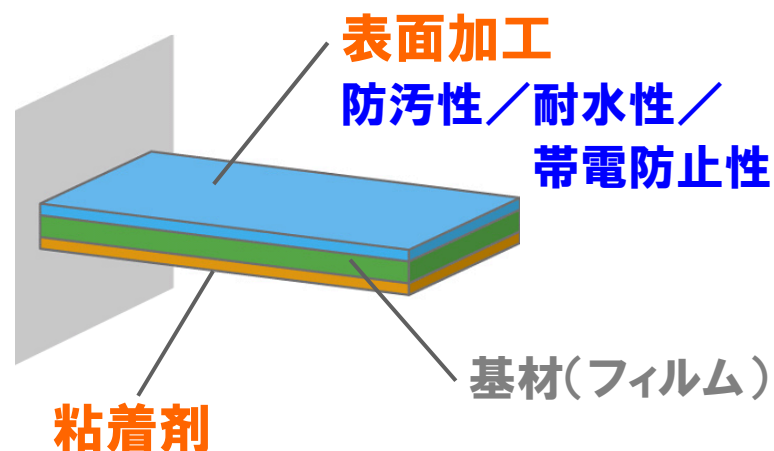
465億円
21.8%



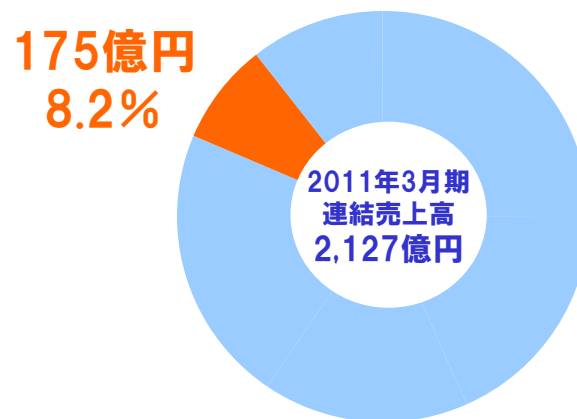
液晶ディスプレイの構成



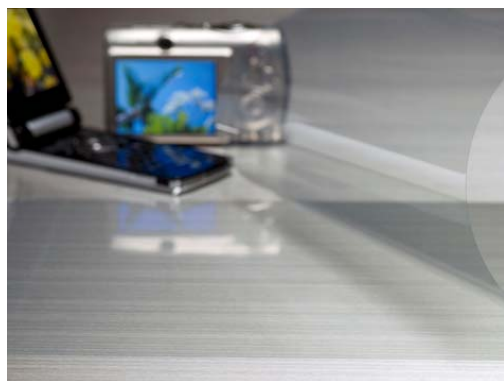
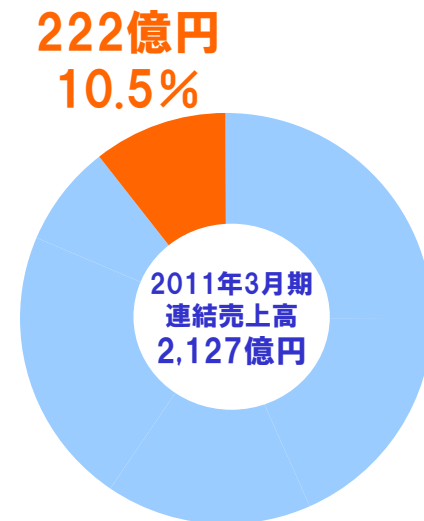
● 偏光フィルム用保護フィルム



- カラー封筒用紙
- 色画用紙
- 無塵紙
- 高級印刷用紙
- 高級紙製品用紙 など



- 粘着製品用剥離紙・剥離フィルム
- 光学製品用剥離フィルム
- FPC*カバーレイ用剥離紙
- 合成皮革用工程紙 (剥離紙)
- 炭素繊維複合材料用工程紙 (剥離紙) など



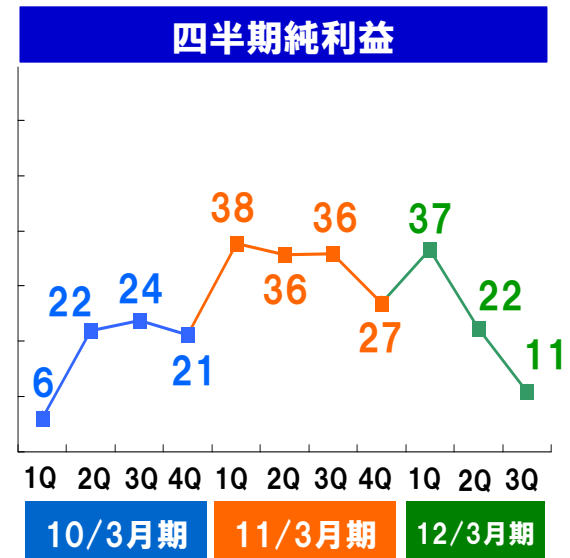
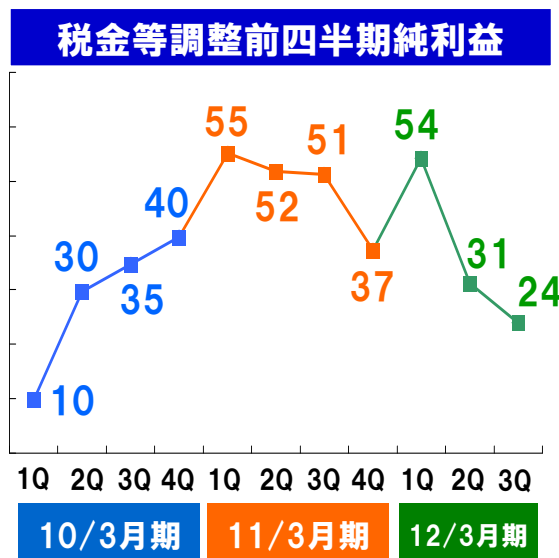
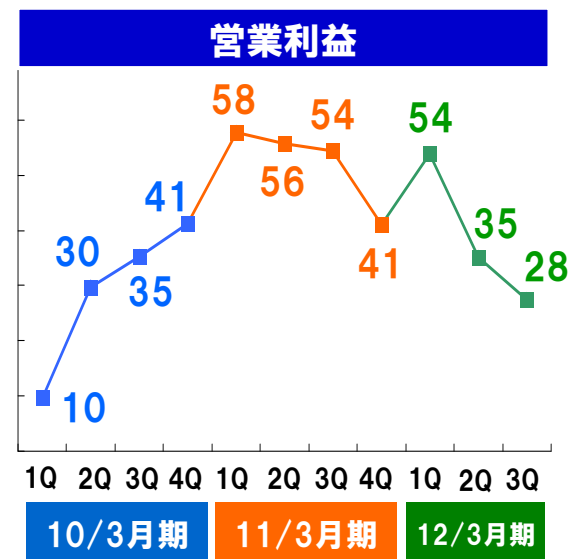
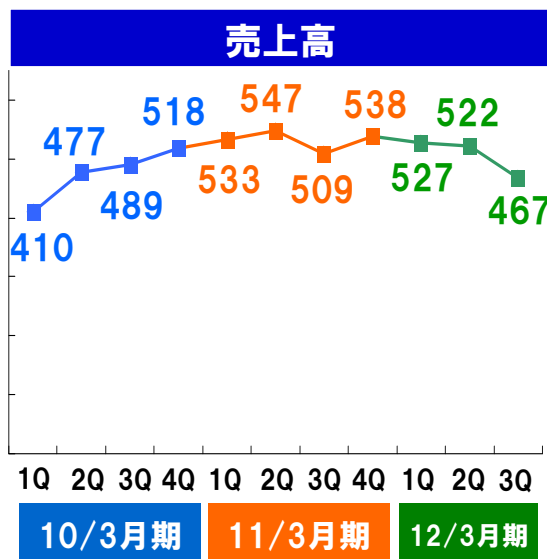
*FPC = フレキシブルプリント基板

2012年3月期第3四半期 連結業績の概要

(単位:億円)

	12/3月期 3Q実績	11/3月期 3Q実績	増減 (増減率)
売上高	1,517	1,589	▲72 (▲4.5%)
営業利益	117	168	▲51 (▲30.4%)
税金等 調整前 四半期 純利益	109	158	▲49 (▲31.0%)
四半期 純利益	70	109	▲39 (▲35.8%)

(単位:億円)

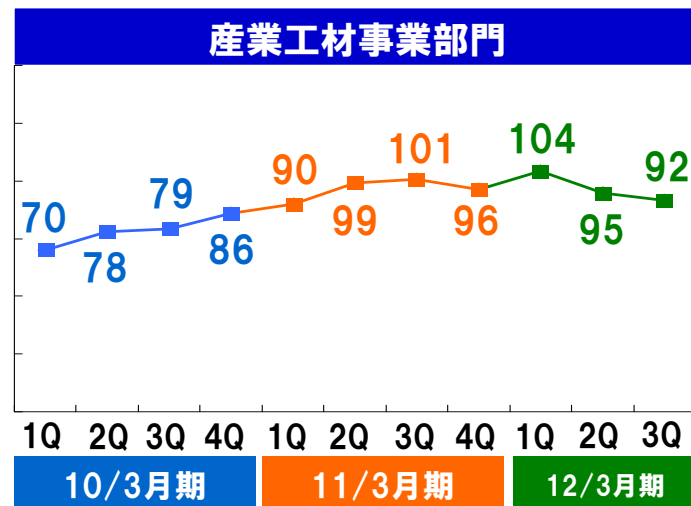
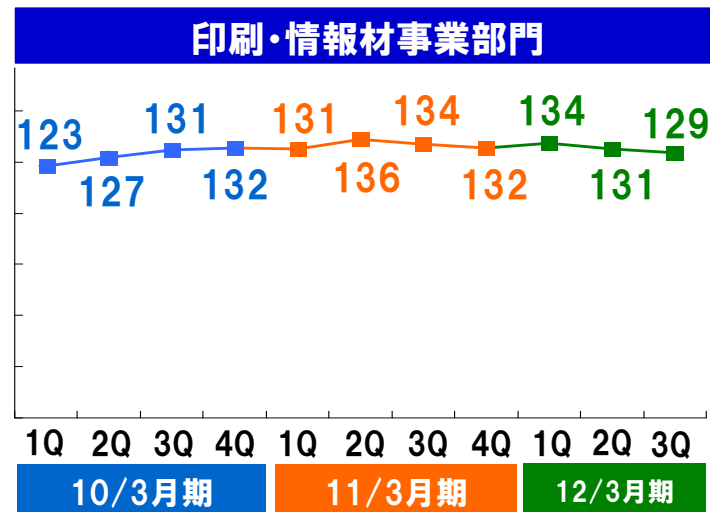


セグメント別売上高/営業利益 印刷材・産業工材関連

(単位:億円)

印刷材・ 産業工材 関連	12/3月期 3Q実績	11/3月期 3Q実績	増減 (増減率)
印刷・情報材 事業部門	395	401	▲6 (▲1.5%)
産業工材 事業部門	290	289	1 (0.3%)
セグメント 売上高	685	691	▲6 (▲0.9%)
セグメント 営業利益	45	65	▲20 (▲30.8%)

事業部門別四半期売上高推移 (単位:億円)



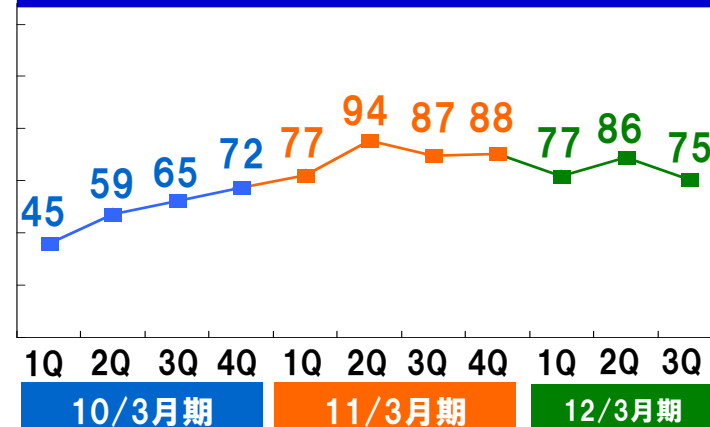
セグメント別売上高/営業利益 電子・光学関連

(単位:億円)

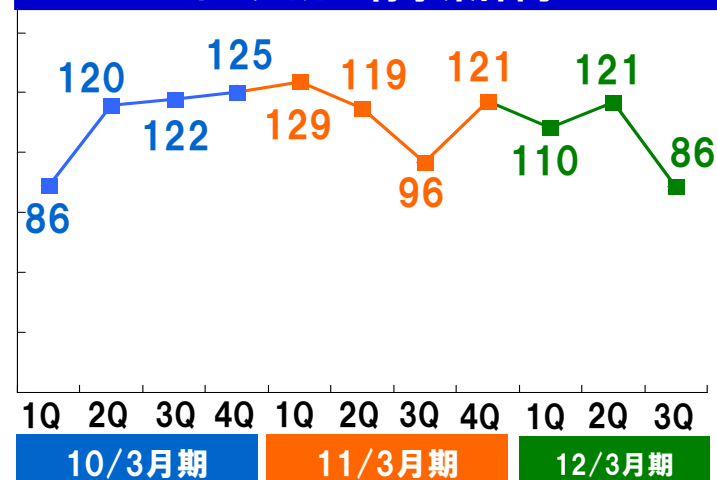
電子・光学 関連	12/3月期 3Q実績	11/3月期 3Q実績	増減 (増減率)
アドバンス マテリアルズ 事業部門	239	259	▲20 (▲7.7%)
オプティカル材 事業部門	317	344	▲27 (▲7.8%)
セグメント 売上高	556	602	▲46 (▲7.6%)
セグメント 営業利益	36	57	▲21 (▲36.8%)

事業部門別四半期売上高推移 (単位:億円)

アドバンスマテリアルズ事業部門



オプティカル材事業部門

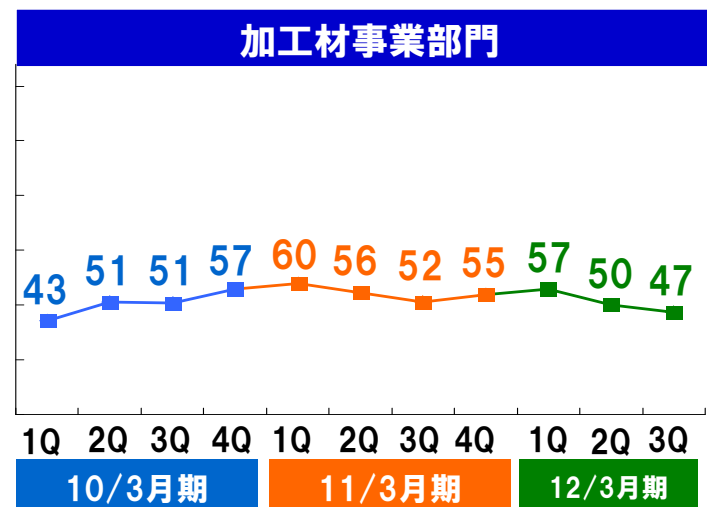
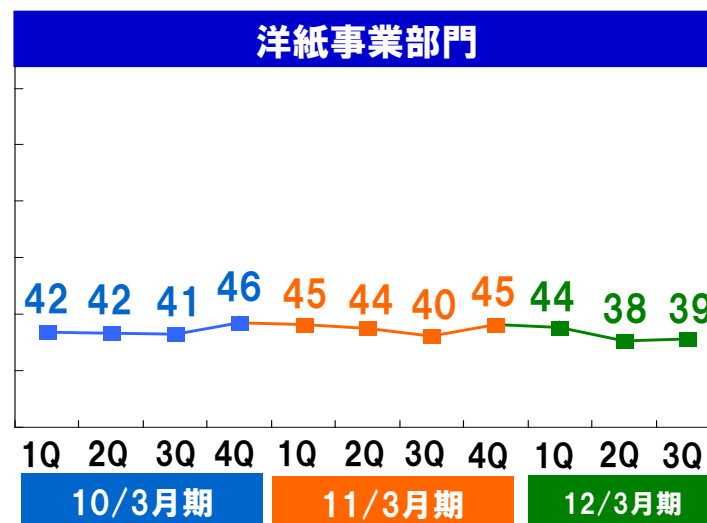


セグメント別売上高/営業利益 洋紙・加工材関連

(単位:億円)

洋紙・加工材 関連	12/3月期 3Q実績	11/3月期 3Q実績	増減 (増減率)
洋紙 事業部門	121	129	▲8 (▲6.2%)
加工材 事業部門	154	167	▲13 (▲7.8%)
セグメント 売上高	275	297	▲22 (▲7.4%)
セグメント 営業利益	36	46	▲10 (▲21.7%)

事業部門別四半期売上高推移 (単位:億円)

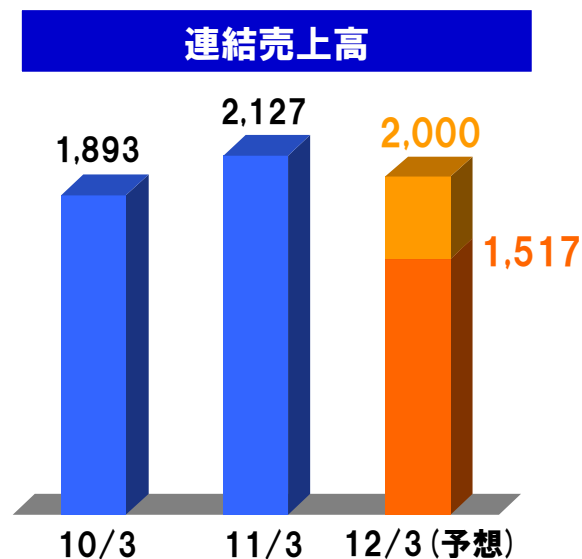


2012年3月期通期 連結業績の見通し

(単位:億円)

	12/3月期 3Q実績	12/3月期 予想	11/3月期 実績
売上高	1,517	2,000	2,127
営業利益	117	140	209
税金等 調整前 当期純利益	109	133	196
当期純利益	70	94	136

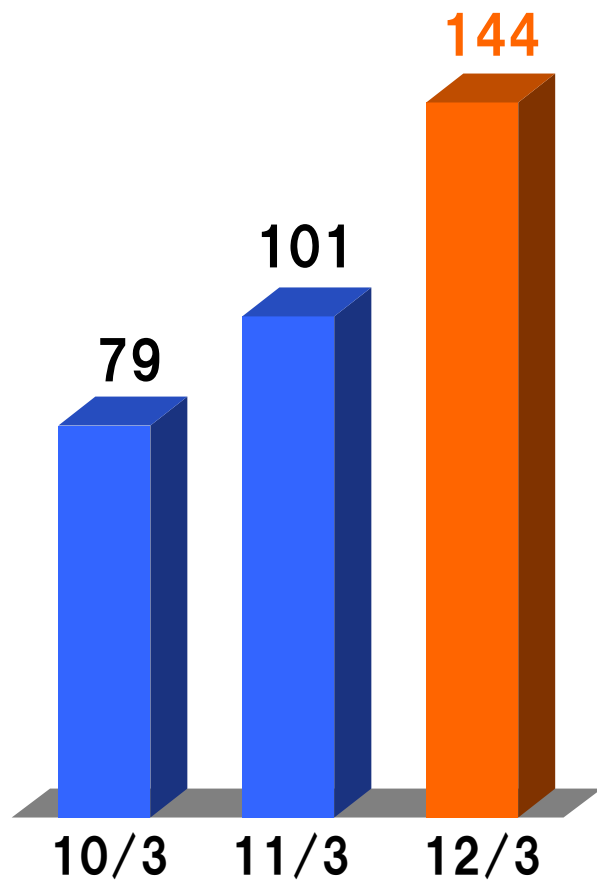
(単位:億円)



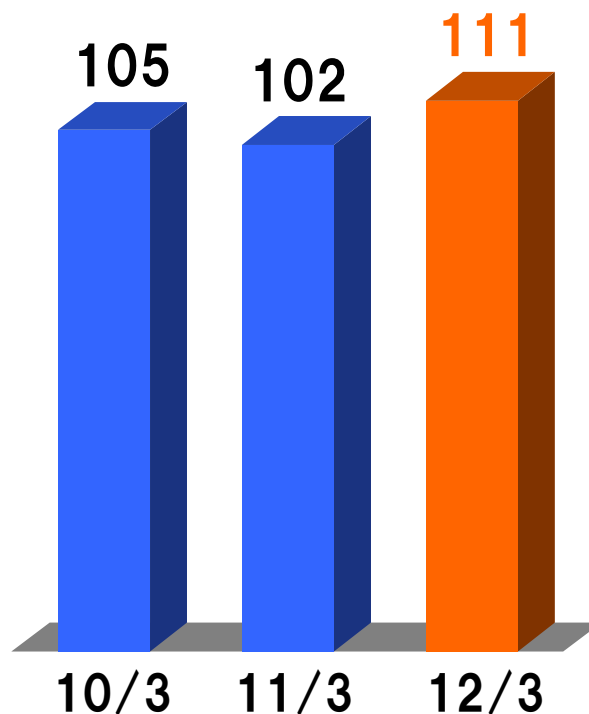
設備投資額・減価償却費・研究開発費

単位:億円 ■実績 ■見通し

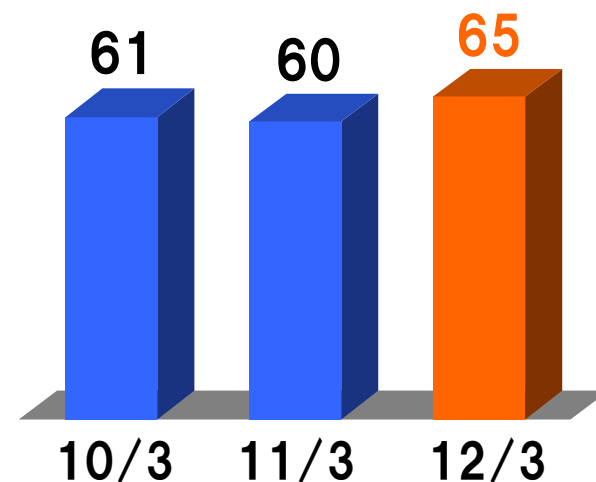
設備投資額



減価償却費



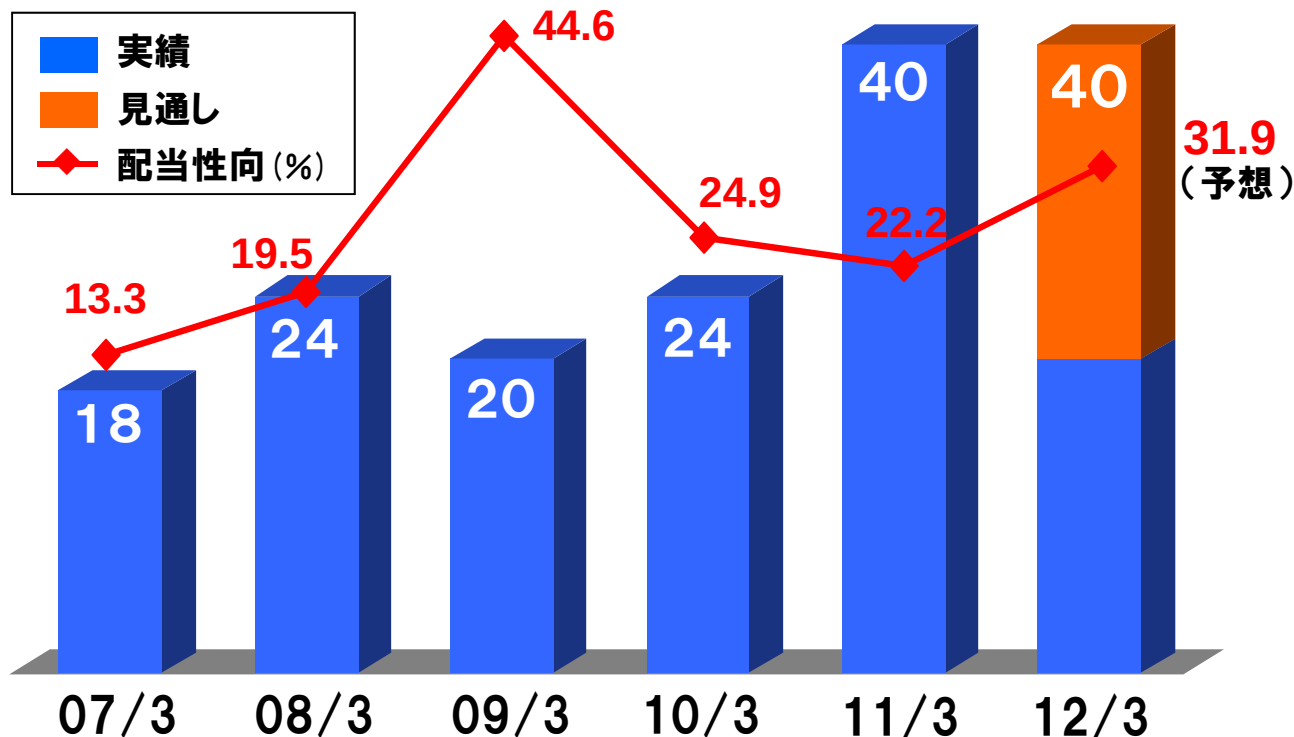
研究開発費



■配当方針

長期的な視野に立った事業収益の拡大並びに財務体質の強化を図るとともに、連結業績を考慮した配当を実施

●1株当たり配当金推移(円)



名 称 LIP-Ⅲ (LINTEC Innovation Plan Ⅲ)

期 間 2011年4月～2014年3月

基本方針 積極果敢にイノベーションに挑戦し、
持続的な成長と企業価値の最大化を目指す

重点テーマ

1. 海外事業の強化・拡大 (海外売上高比率40%)
2. QCD強化による国内事業の拡大と高収益化
3. 次世代を担う独創的新製品の創出
4. グローバル経営の強化

最終年度の主要数値目標 (連結ベース)

■売上高	2,600億円	■売上高営業利益率	10%以上
■営業利益	260億円	■ROE (自己資本利益率)	10%以上
■純利益	170億円	■ROIC (投下資本利益率)	10%以上

設備投資額・減価償却費・研究開発費 (3か年合計)

■設備投資額	427億円
■減価償却費	377億円
■研究開発費	205億円

本資料および当社製品などに関するお問い合わせ先

リンテック株式会社 広報・IR室

〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

TEL.03-5248-7741

本資料に掲載されている業績見通しに関する内容につきましては、本資料の作成日現在において想定できる経済情勢、市場動向および計画などに基づき作成したものであり、その内容の正確性を保証したり、将来の計画数値、施策の実現を確約したりするものではありません。したがって、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。